



要粘接 · 找凯富乐

技术资料

XR-TP080-V

有机硅导热灌封胶

一、产品概述

XR-TP080-V 为 1:1 双组份加成型有机硅导热灌封胶，具备导热与阻燃双重核心性能

主要用途

- 1.各种电子电器元件的导热、阻燃灌封
- 2.光伏逆变器、
- 3.LED 驱动电源
- 4.充电桩、汽车电子、
- 5.新能源汽车电源及控制器等

产品特性

- 1.导热好，便于散热
- 2.流动性好，易于排泡
- 3.电气绝缘性能优，长期保护电子元器件
- 4.防尘防水
- 5.耐老化性能优异，在-50 ~ 200℃内保持橡胶弹性

二、技术参数

1.固化前特性

类型	A 组分	B 组分
粘度 mPa·s GB/T2794-2013	2000±500	2000±500
颜色	白色	灰黑色
体积混合比	1	1

2.混合特性

类型	指标
粘度 mPa·s GB/T2794-2013	2000±500
颜色	灰色弹性体
密度 g/cm ³ GB/T13354-1992	1.64±0.08
可操作时间 min	60-120
固化时间	30min@ 70℃; 24hr@ 25℃
硬度 Shore A GB/T531.1-2008	50±5
拉伸强度 MPa GB/T528-2009	1.5
导热系数 W/m·K ISO22007-2-2015	0.8
耐压强度 KV/mm GB/T1695-2005	15
体积电阻率Ω·cm GB/T1692-2008	10 ¹⁴
阻燃等级 GB/T2408-2021	V0

三、使用说明

准备：A、B 组分先分别用手动或机械进行充分搅拌，避免因填料沉降而导致性能发生变化

混合：按 1:1 重量比准确称量两组份放入干净的容器内搅拌均匀

脱泡：混合后的胶水灌入元件后静置 20-30min（自然脱泡）

真空度 0.08-0.1MPa，抽 5-10min 后灌注（真空脱泡）

灌注：基材表面保持清洁干燥。应在胶水仍有较好流动性时将胶水灌注完毕，否则影响流平

固化：室温或加热均可固化。固化速度随温度升高而加快，冬季时建议加热固化



要粘接 · 找凯富乐

技术资料

XR-TP080-V

有机硅导热灌封胶

四、储存须知

8-28℃阴凉干燥环境密封存储。贮存期：12 个月

五、注意事项

胶料密封贮存，远离儿童存放；

胶液接触一定量的以下化学物质会不固化：

N、P、S 有机化合物；Sn、Pb、Hg、As 等元素的离子性化合物；含炔烃及多乙烯基化合物；

为了避免上述现象，所以在线路板上使用时尽量擦干净上面残留的松香，尽量使用低铅含量的焊锡。

六、质量声明

本产品符合工业应用标准，但实际性能受储存、操作及环境影响。制造商仅对产品本身质量负责，不对非可控因素导致的间接损失承担责任。